第一图书网, tushu007.com

<<现代印制电路原理与工艺>>

图书基本信息

书名：<<现代印制电路原理与工艺>>

13位ISBN编号：9787111184942

10位ISBN编号：7111184947

出版时间：2006-2

出版时间：机械工业

作者：张怀武

页数：381

字数：613000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书从印制电咱基板材料、设计、制造、装配、焊接、质量保证、环保和质量标准等方面全面系统地讲述了印制电路技术的基本概念、原理和工艺，以及最新的印制板制造工艺和技术，涵盖了各类制板制造所必须工艺，以及最新的印制板制造工艺和技术，涵盖了各类印制板制造所必须掌握的基本知识和实际知识，力求科学性、先进性、新颖性和实用性的统一。
鉴于印制电路技术飞速发展，本书还增加了即将成为印制电路主要生产技术的高密度互连积层印制电路、特殊用途的特种印制电路技术、集成元件印制板和印制电路发展趋势等内容。
本书共分18章，着重基本概念和原理的阐述，深入浅出，理论联系实际。
每章都配有习题，以指导读者深入地进行学习。
　本教材收集了国外印制电路技术方面大量的新资料，并结合我国现有的生产工艺的实际情况编写而成，具有一定的理论性和较强的实用价值。
本书可作为高等院校电气信息类和化学类印制电路技术的教材，对从事印制电路行业的工程技术人员也是一部好的参考书。

书籍目录

出版说明前言第1章 印制电路概述 1.1 印制电路的定义和功能 1.2 印制电路的发展史、分类和特点 1.3 印制电路制造工艺简介 1.4 我国印制电路制造工艺简介 1.5 习题第2章 基板材料 2.1 覆铜箔层压板及其制造方法 2.2 覆铜箔层压板的各种特性 2.3 覆铜箔层压板电性能测试 2.4 习题第3章 印制板设计与布线 3.1 设计的一般原则 3.2 设计应考虑的因素 3.3 CAD设计技术 3.4 习题第4章 照相制版技术……第5章 图形转移第6章 化学镀与电镀技术第7章 孔金属化技术第8章 蚀刻技术第9章 焊接技术第10章 多层印制电路第11章 挠性及刚挠印制电路板第12章 高密度互连积层多层板工艺第13章 集成元件印制板第14章 特种印制板技术第15章 印制电路清洗技术第16章 印制电路生产的三废控制第17章 印制板质量与标准第18章 印制电路技术现状与发展趋势参考文献

编辑推荐

其他版本请见：《现代印制电路原理与工艺（第2版）（附电子教案）》

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com